

Soldeerpasta AP-10, Bi57Sn42Ag1

Soldeerpasta NO-CLEAN, loodvrij, metaalgehalte 88%, legering Bi57Sn42Ag1, korrelgrootte T3, smelttraject: 137°C-139°C

Artikelnr.	WL83324
Fabrikant	TAMURA ELSOLD
Fabrikant artikelnr.	LOTPAST0043
GPSR-fabrikantgegevens	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Verkoopenheid	1 bussen
Inhoudseenheid	1 Blikken
Incl. batterij	nee
Loodvrij/loodhoudend	ongelood
Metaalgehalte	88 %